

2021年半导体所拟转让专利情况公示（四）

公示时间：2021年10月26日至2021年11月9日 联系人：曹永胜 邮箱：yscao@semi.ac.cn 电话：82304880

序号	合同名称	专利名称	发明人	专利号	所属研究组	研究组负责人	转让形式	拟转让的公司	合同金额（万元）
1	三种SiC器件设计及其制备方法	碳化硅半导体器件及其制备方法	温正欣 张峰 申占伟 田丽欣 闫果果赵万顺 王雷 刘兴昉 孙国胜 曾一平	ZL201710076020.0	分子束外延微结构材料研究组	刘兴昉	专利权转让	杭州光学精密机械研究所	150
		一种SiC基沟槽型场效应晶体管及其制备方法	申占伟 张峰 赵万顺 王雷 闫果果 温正欣 刘兴昉 孙国胜 曾一平	ZL201610859254.8					
		一种碳化硅MOSFET器件及其制备方法	田丽欣 温正欣 张峰 赵万顺 王雷 刘兴昉 闫果果 孙国胜 曾一平	ZL201610150734.7					